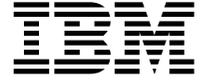


IBM Power System S822LC for Big Data (8001-22C) 1% 3! H;-



IBM Power® System S822LC for Big Data (8001-22C) 빠른 설 치 안내서

IBM Knowledge Center는 http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER8/p8hdx/8001_22c_landing.htm에서 온라인으로 사용 가능합니다.

- 중요 부품 관련 작업을 시작하기 전에 모든 예방 조치와 지시사항을 잘 읽으십시오.
- 시스템 및 부품 관련 작업을 수행할 때는 일반 ESD(Electrostatic Discharge) 프로시저를 사용하십시오. IBM에서는 장비에 손상을 줄 수 있는 가능성을 피하도록 장갑과 정전기 방지 밴드를 착용하도록 권고합니다.

8001-22C 정보: <https://ibm.biz/8001-22CQR>

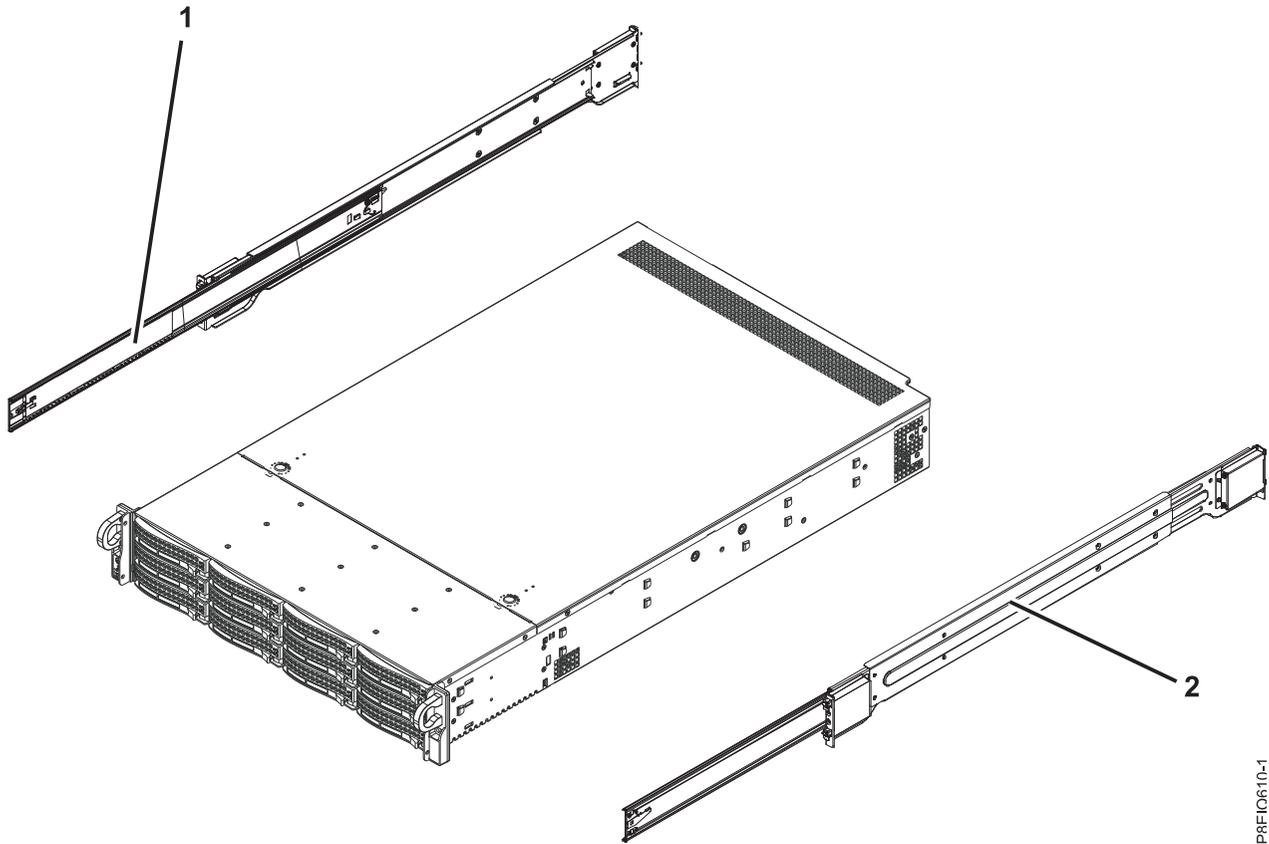


8001-22C 부품

이 정보를 사용하여 FRU(Field-Replaceable Unit) 부품 번호를 찾을 수 있습니다.

주문할 부품의 부품 번호를 식별한 후에 고급 부품 교환 보증 서비스로 이동하십시오. 이 경우 등록이 필요합니다. 부품 번호를 식별할 수 없는 경우에는 IBM® 서비스 및 지원 팀에 문의로 이동하십시오.

랙 최종 어셈블리



P8F1Q610-1

그림 1. 랙 최종 어셈블리

표 1. 랙 최종 어셈블리 부품 번호

색인 번호	부품 번호	어셈블리당 장치 수	설명
1	MCP-290-00057-0N	1	슬라이드 레일 키트 - 왼쪽 및 오른쪽 슬라이드 레일 및 연결 나사가 포함됨
2	MCP-290-00057-0N	1	슬라이드 레일 키트 - 왼쪽 및 오른쪽 슬라이드 레일 및 연결 나사가 포함됨

시스템 부품

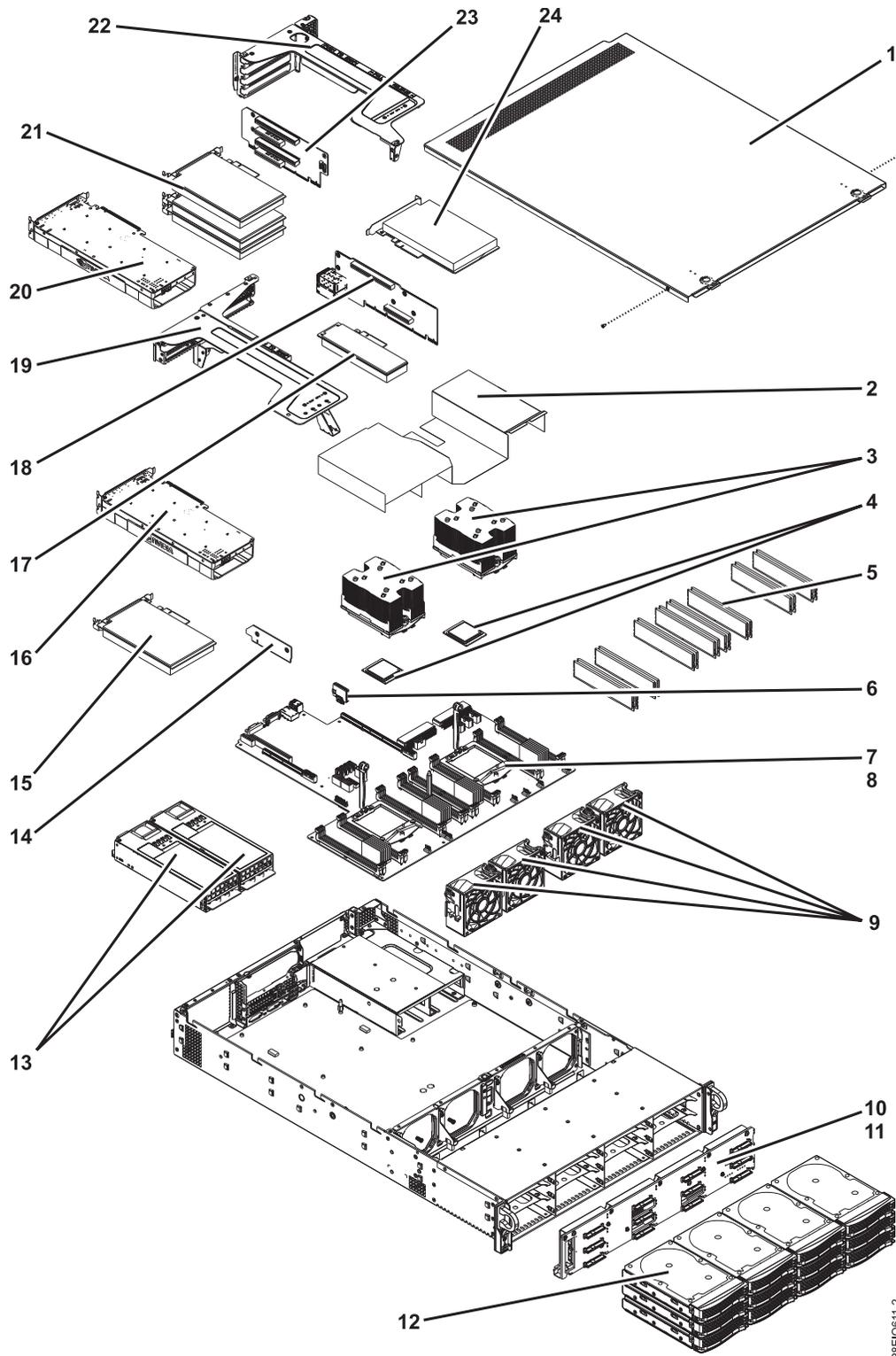


그림 2. 시스템 부품

P8EIO611-2

표 2. 시스템 부품

색인 번호	부품 번호	어셈블리당 장치 수	설명
1		1	맨 위 커버 어셈블리
		2	나사
2	MCP-310-82914-0B	1	CPU 에어 배플
3	SNK-P0053P-IB001	2	방열판 키트(방열판 및 TIM 포함)
4	00UL866	2	8 코어 3.325GHz 시스템 프로세서 모듈
	00UL864	2	10 코어 2.926GHz 시스템 프로세서 모듈
	00UL010	2	11 코어 2.893GHz 시스템 프로세서 모듈
5	MTA9ASF51272PZ-2G3B16	16	4GB, 2400MHz 1RX8 DDR4 RDIMM(Micron Technology, Inc.)*
	MTA9ASF1G72PZ-2G3B16	16	8GB, 2400MHz 1RX8 DDR4 RDIMM(Micron Technology, Inc.)*
	MTA18ASF2G72PZ-2G3B16	16	16GB, 2400MHz 1RX4 DDR4 RDIMM(Micron Technology, Inc.)*
	MTA36ASF4G72PZ-2G3B16	16	32GB, 2400MHz 2RX4 DDR4 RDIMM(Micron Technology, Inc.)*
	M393A1G40DB0-CPB	16	8GB, 2133MHz 1RX4 DDR4 RDIMM(Samsung Electronics Co., Ltd.)*
	M393A2G40DB0-CPB	16	16GB, 2133MHz 2RX4 DDR4 RDIMM(Samsung Electronics Co., Ltd.)*
	M393A4K40BB0-CPB	16	32GB, 2133MHz 2RX4 DDR4 RDIMM(Samsung Electronics Co., Ltd.)*
	HMA41GR7AFR4N-TF	16	8GB, 2133MHz 1RX4 DDR4 RDIMM(SK hynix, Inc.)*
	HMA42GR7AFR4N-TF	16	16GB, 2133MHz 2RX4 DDR4 RDIMM(SK hynix, Inc.)*
	HMA84GR7MFR4N-TF	16	32GB, 2133MHz 2RX4 DDR4 RDIMM(SK hynix, Inc.)*
6	SSD-DM064-PHI	2	64GB SATA DOM(Drive On Module)
	SSD-DM128-SMCMVN	2	128GB SATA DOM(Drive On Module)
7	MBD-P8DTU	1	시스템 백플레인
8		10	나사
9	FAN-0166L4	4	팬
10	BPN-SAS3-826A	1	디스크 드라이브 백플레인(12 SAS 또는 SATA 드라이브 지원)
	BPN-SAS3-826EL1-N4	1	디스크 드라이브 백플레인(8 SAS 또는 SATA 드라이브 및 4 SAS, SATA 또는 NVMe 드라이브 지원)
11		7	나사
12	HDD-A2000-ST2000NM003401	12	2TB 3.5인치 SAS 디스크 드라이브
12	HDD-A4000-ST4000NM003401 또는 HDD-A4TB-HUS726040AL5210	12	4TB 3.5인치 SAS 디스크 드라이브
12	HDD-A6000-ST6000NM003401	12	6TB 3.5인치 SAS 디스크 드라이브
12	HDD-A8000-ST8000NM0075	12	8TB 3.5인치 SAS 디스크 드라이브

표 2. 시스템 부품 (계속)

색인 번호	부품 번호	어셈블리당 장치 수	설명
12	HDD-A 4000-ST4000NM0075	12	4TB 3.5인치 자체 암호화 SAS 디스크 드라이브
12	HDD-A 8000-ST8000NM0095	12	8TB 3.5인치 자체 암호화 SAS 디스크 드라이브
12	HDD-T 2000-ST2000NM002401	12	2TB 3.5인치 SATA 디스크 드라이브
12	HDD-T 4000-ST4000NM002401	12	4TB 3.5인치 SATA 디스크 드라이브
12	HDD-T 6000-ST6000NM002401	12	6TB 3.5인치 SATA 디스크 드라이브
12	HDD-T 8000-ST8000NM0055	12	8TB 3.5인치 SATA 디스크 드라이브
12	HDS-KIT-2A-1920-IB001	12	1.9TB 소형 폼 팩터 SAS SSD(Solid-State Drive)(매일 1 드라이브 쓰기)
12	HDS-KIT-2A-3840-IB001	12	3.8TB 소형 폼 팩터 SAS SSD(Solid-State Drive)(매일 1 드라이브 쓰기)
12	HDS-KIT-2T-160-IB001	12	160GB 2.5인치 소형 폼 팩터 SATA SSD(Solid-State Drive)
12	HDS-KIT-2T-240-IB001	12	240GB 2.5인치 소형 폼 팩터 SATA SSD(Solid-State Drive)
12	HDS-KIT-2T-960-IB001	12	960GB 2.5인치 소형 폼 팩터 SATA SSD(Solid-State Drive)
12	HDS-KIT-2T-1900-IB001	12	1.9TB 2.5인치 소형 폼 팩터 SATA SSD(Solid-State Drive)
12	HDS-KIT-2T-3800-IB001	12	3.8TB 2.5인치 소형 폼 팩터 SATA SSD(Solid-State Drive)
12	HDS-KIT-3N-800-IB001	4	800GB 2.5인치 소형 폼 팩터 NVMe 드라이브(매일 3 드라이브 쓰기)
12	HDS-KIT-3N-1200-IB001	4	1.2TB 2.5인치 소형 폼 팩터 NVMe 드라이브(매일 3 드라이브 쓰기)
12	HDS-KIT-3N-1600-IB001	4	1.6TB 2.5인치 소형 폼 팩터 NVMe 드라이브(매일 3 드라이브 쓰기)
12	HDS-KIT-3N-2000-IB001	4	2.0TB 2.5인치 소형 폼 팩터 NVMe 드라이브(매일 3 드라이브 쓰기)
12	HDS-KIT-5N-800-IB001	4	800GB 2.5인치 소형 폼 팩터 NVMe 드라이브(매일 5 드라이브 쓰기)
12	HDS-KIT-5N-3200-IB001	4	3.2TB 2.5인치 소형 폼 팩터 NVMe 드라이브(매일 5 드라이브 쓰기)
13	PWS-1K62A-1R	2	전원 공급 장치
14	RSC-R1UW-E8R	1	PCIe 어댑터 3용 PCIe 라이저(PLX 슬롯1)
15		1	PCI 어댑터. 어댑터의 기능 유형을 사용하여 8001-22C에 대한 기능 유형별 PCIe 어댑터 정보에서 FRU 번호를 찾을 수 있습니다.

표 2. 시스템 부품 (계속)

색인 번호	부품 번호	어셈블리당 장치 수	설명
16		1	GPU. GPU의 기능 유형을 사용하여 에 대한 기능 유형별 PCIe 어댑터 정보8001-22C에 대한 기능 유형별 PCIe 어댑터 정보에서 FRU 번호를 찾을 수 있습니다.
17		1	PCI 어댑터. 어댑터의 기능 유형을 사용하여 8001-22C에 대한 기능 유형별 PCIe 어댑터 정보에서 FRU 번호를 찾을 수 있습니다.
18	AOC-2UR66-i4XTF	1	통합 4-포트 10GbE Base-T, Intel XL710 및 CAPI의 2U UIO NIC PCIe 어댑터 참고: 또한 이 PCIe 어댑터는 PCIe 라이저입니다.
19		1	PCIe 케이지
20		1	GPU. GPU의 기능 유형을 사용하여 에 대한 기능 유형별 PCIe 어댑터 정보8001-22C에 대한 기능 유형별 PCIe 어댑터 정보에서 FRU 번호를 찾을 수 있습니다.
21		3	PCIe 어댑터. 어댑터의 기능 유형을 사용하여 8001-22C에 대한 기능 유형별 PCIe 어댑터 정보에서 FRU 번호를 찾을 수 있습니다.
22		1	PCIe 라이저
23	RSC-W2-688P	1	PCIe 라이저 PCIe 어댑터 4 또는 GPU 2(WIO 슬롯1), PCIe 어댑터 5(WIO 슬롯2) 및 PCIe 어댑터 6(WIO 슬롯3)
24		1	PCI 어댑터. 어댑터의 기능 유형을 사용하여 8001-22C에 대한 기능 유형별 PCIe 어댑터 정보에서 FRU 번호를 찾을 수 있습니다.

*8001-22C 시스템의 모든 메모리는 동일한 크기여야 하며 동일한 제공업체의 제품이어야 합니다. 8001-22C 시스템에서는 서로 다른 크기의 메모리나 서로 다른 공급업체의 메모리를 혼용할 수 없습니다.

뒷면 포트

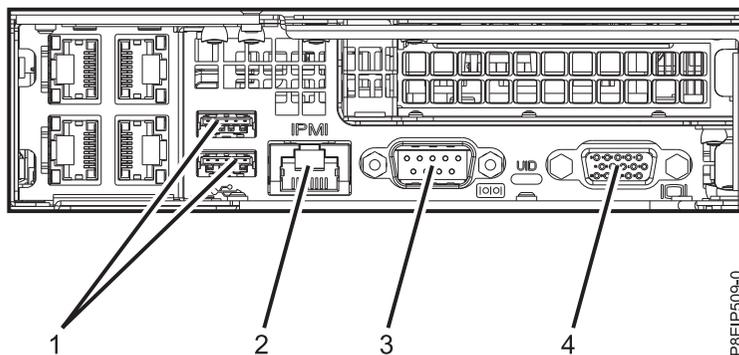


그림 3. 뒷면 포트

표 3. 입력 및 출력 포트

ID	설명
1	키보드와 마우스에 사용되는 USB 2.0

표 3. 입력 및 출력 포트 (계속)

ID	설명
2	이더넷 IPMI(Intelligent Platform Management Interface)
3	직렬 IPMI
4	모니터에 사용되는 VGA(Video Graphics Array). 60Hz의 1024 x 768 VGA 설정만 지원됩니다. 최대 3미터까지만 케이블이 지원됩니다. 텍스트 기반 기능은 이 시점에만 지원됩니다.

설치 및 제거

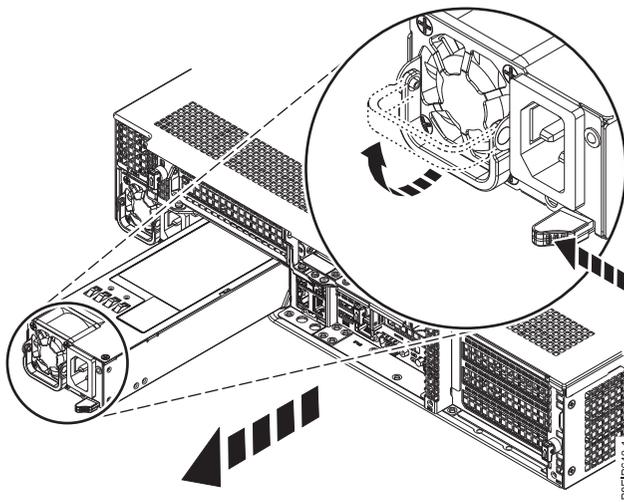


그림 4. 시스템에서 전원 공급 장치 제거

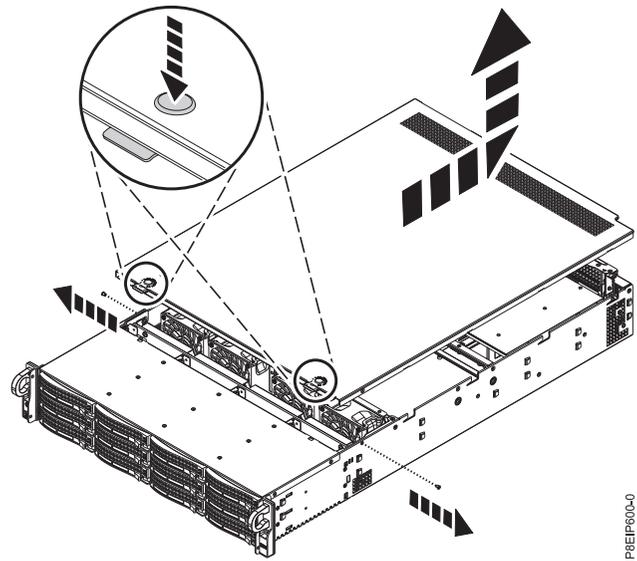


그림 5. 커버 해제 및 열기

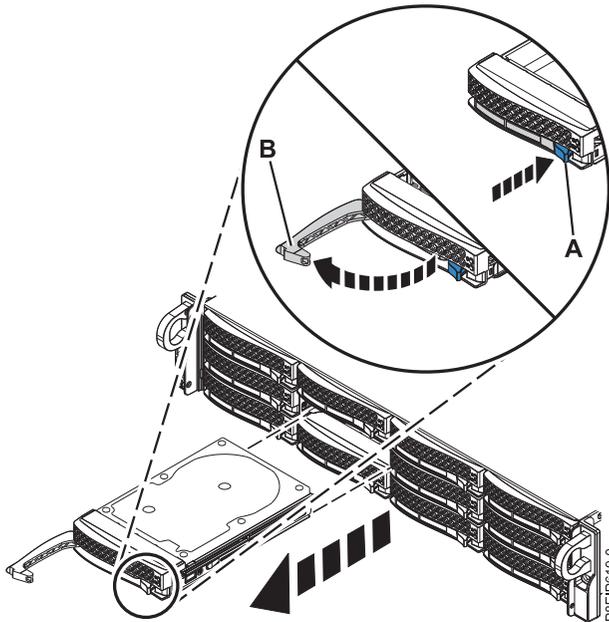


그림 6. 드라이브 제거

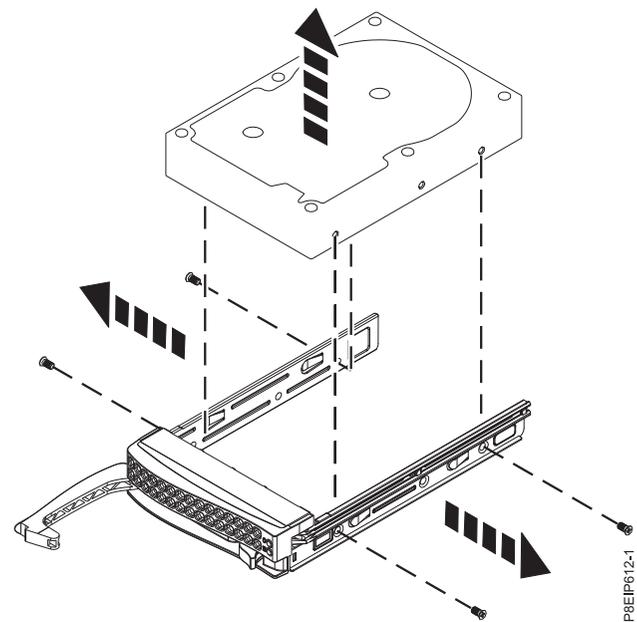


그림 7. 트레이에서 3.5인치 드라이브 제거

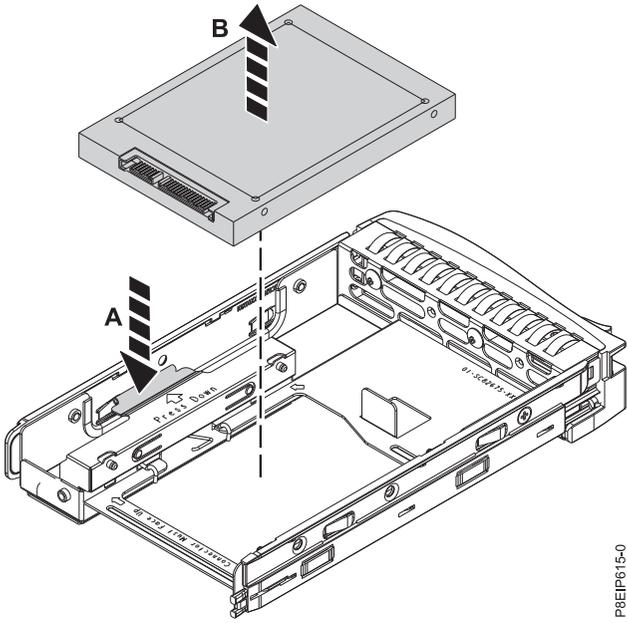


그림 8. 트레이에서 2.5인치 드라이브 제거

P8EIP615-0

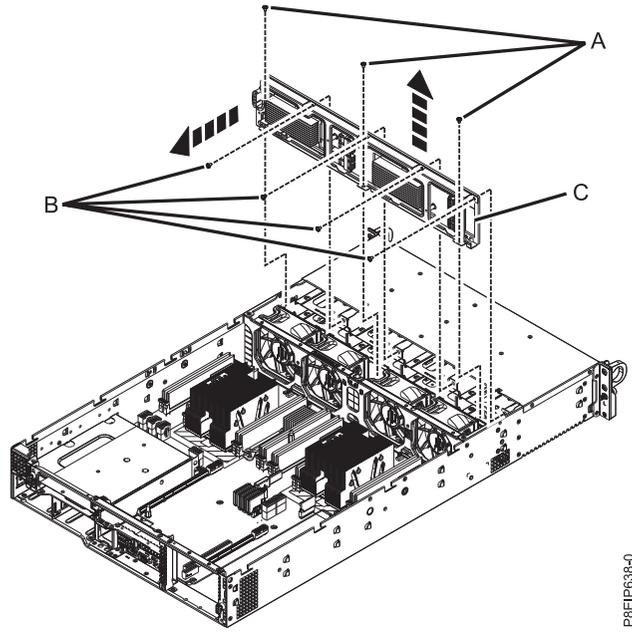


그림 9. 디스크 드라이브 백플레인 및 나사 제거

P8EIP635-0

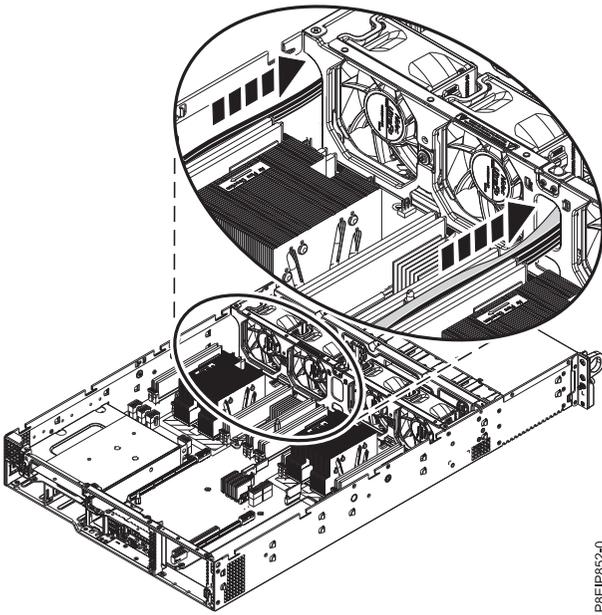


그림 10. 디스크 드라이브 백플레인 케이블 제거

P8EIP852-0

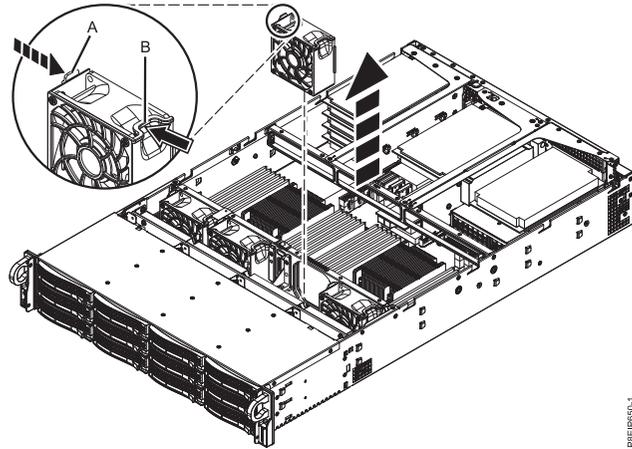


그림 11. 팬 제거

P8EIP650-1

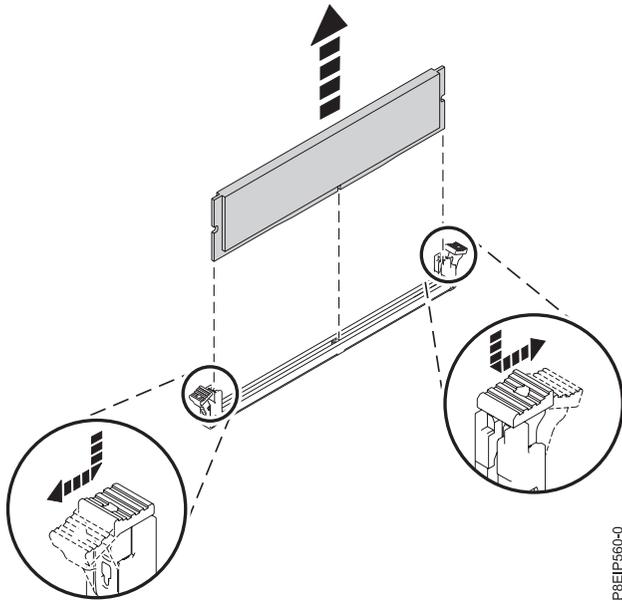


그림 12. 메모리 제거

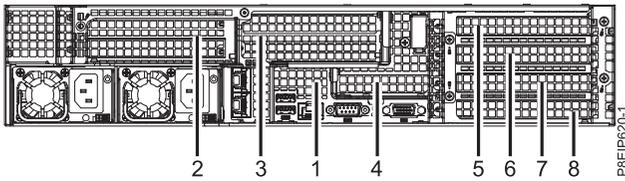


그림 14. 8001-22C PCIe 어댑터 위치

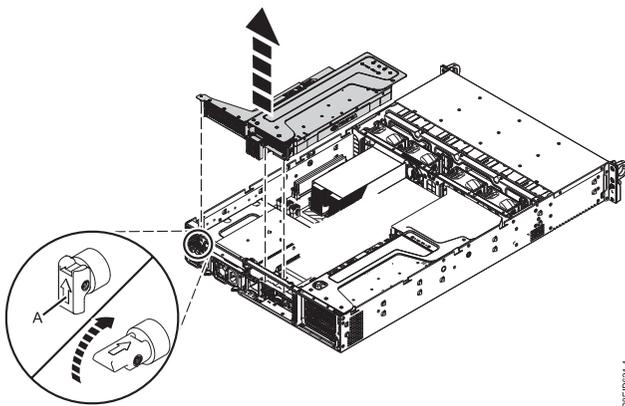


그림 15. PCIe 라이저 제거

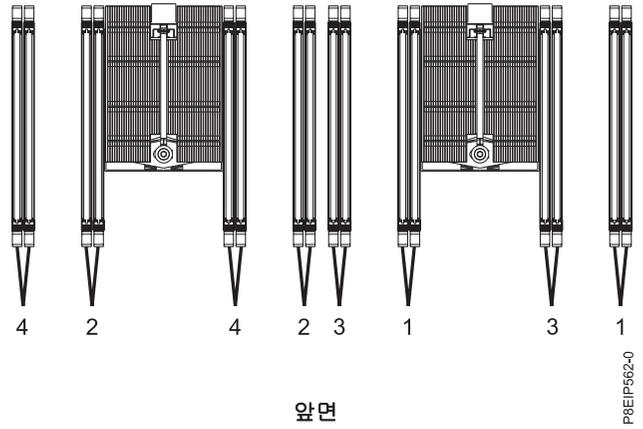


그림 13. 메모리 슬롯 위치 및 플러깅 시퀀스

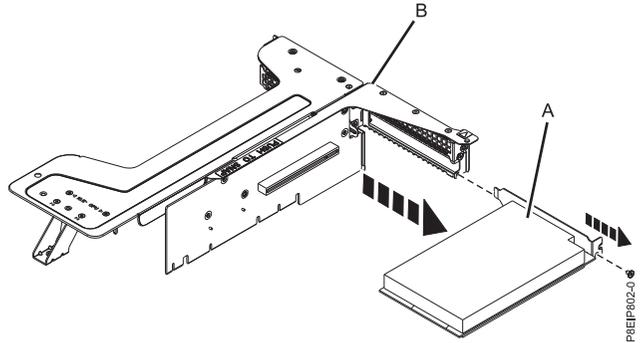


그림 16. 라이저에서 위치 2 어댑터 제거

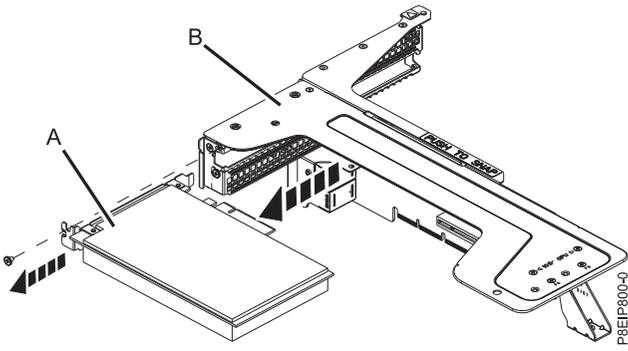


그림 17. 라이저에서 위치 3 어댑터 제거

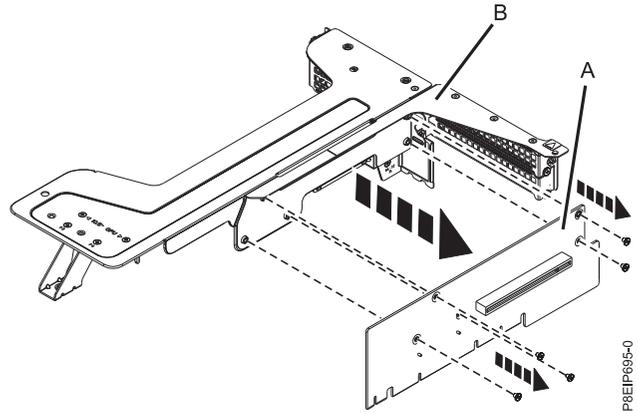


그림 18. 위치 1 라이저 카드 제거

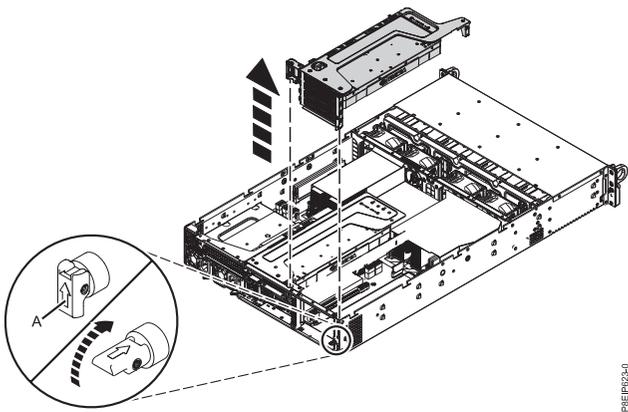


그림 19. PCIe 라이저 제거

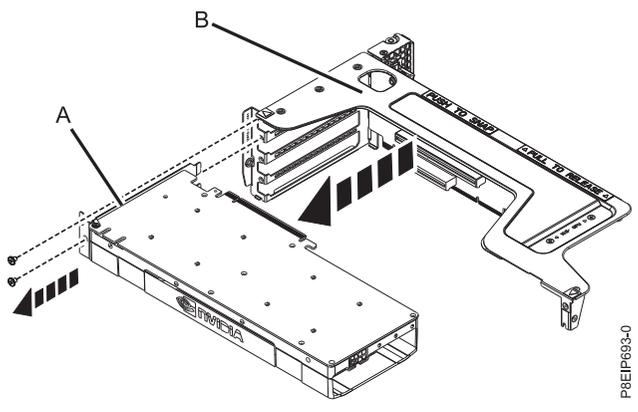


그림 20. 라이저에서 GPU 제거

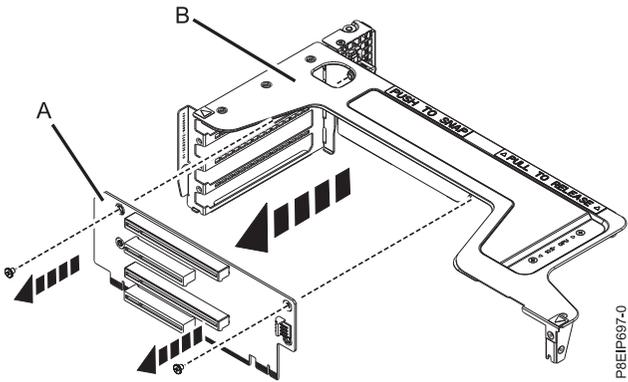


그림 21. 위치 5, 6, 7 및 8 라이저 카드 제거

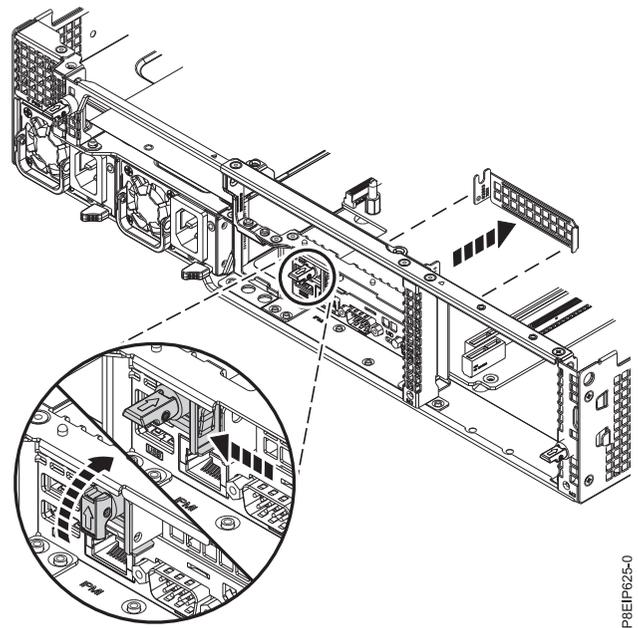


그림 22. 심압대 해제

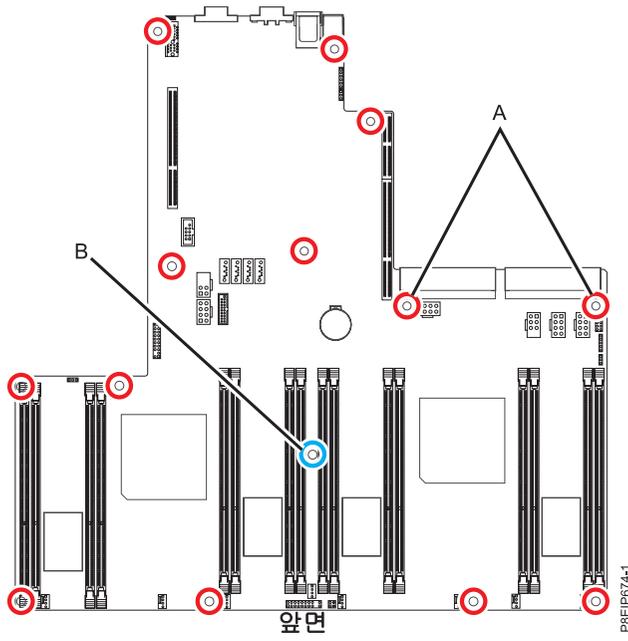


그림 23. 나사 위치

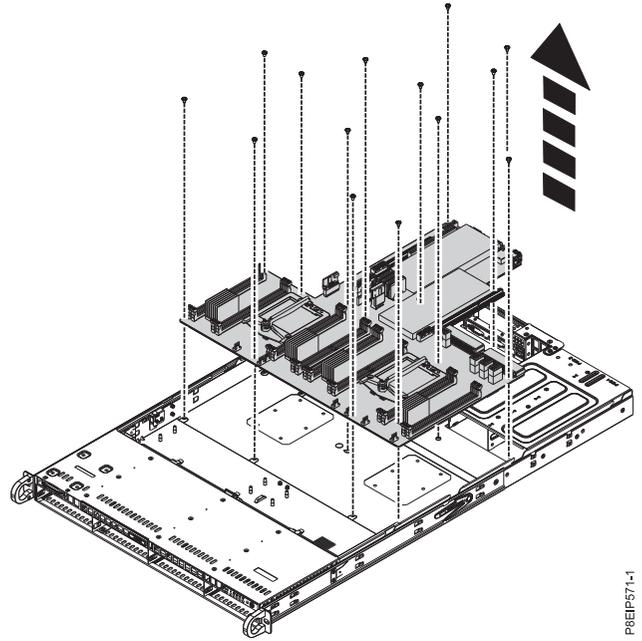


그림 24. 시스템 백플레인 들어올리기

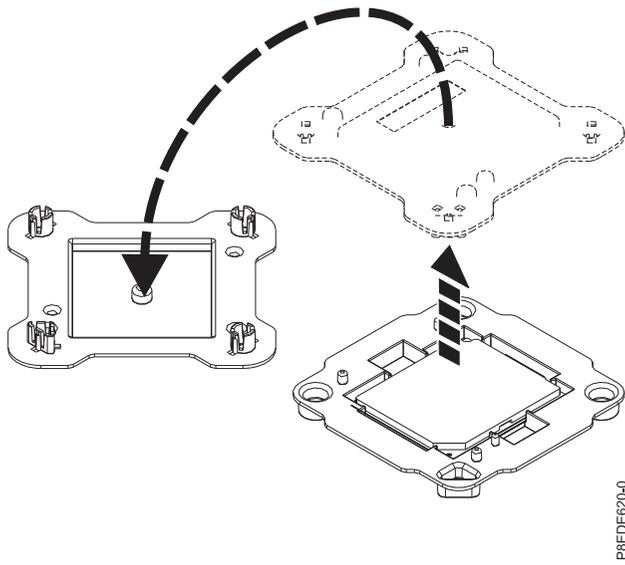


그림 25. 시스템 프로세서 모듈 패키징 열기

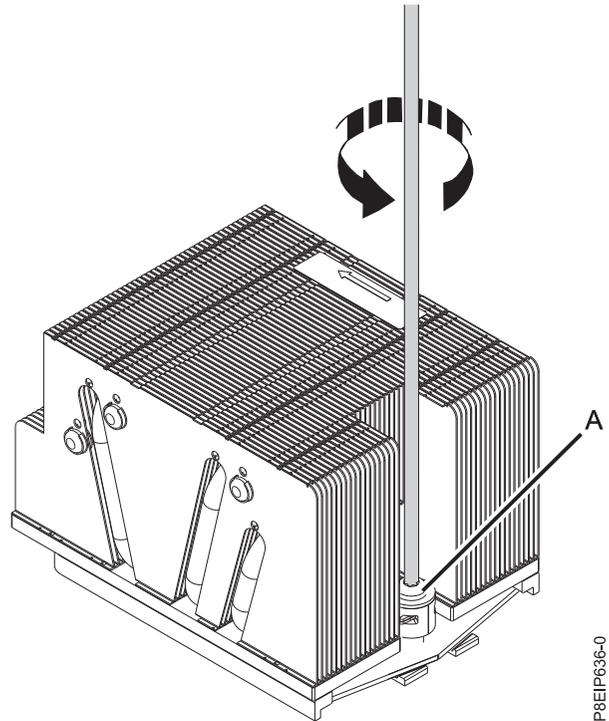


그림 26. 방열판의 로드 암 나사 풀기

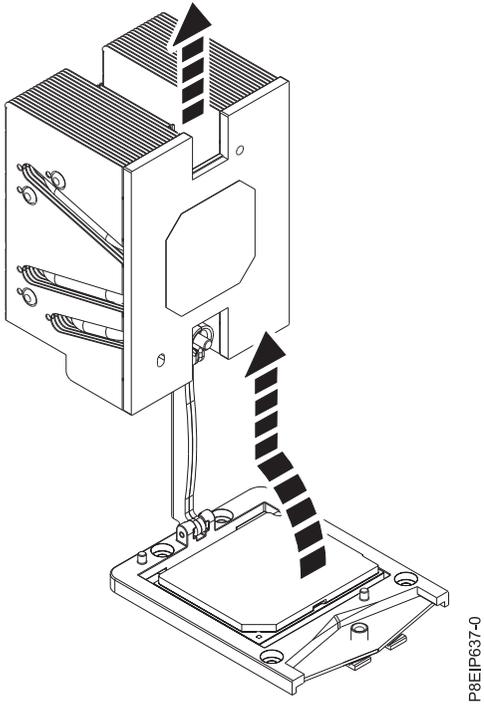


그림 27. 로드 암에서 방열판 들어올리기

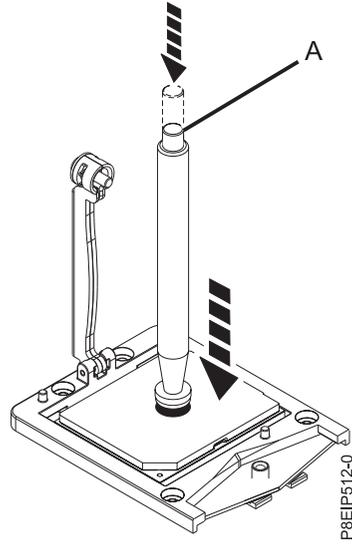


그림 28. 시스템 프로세서 모듈에 진공 펜 잠금

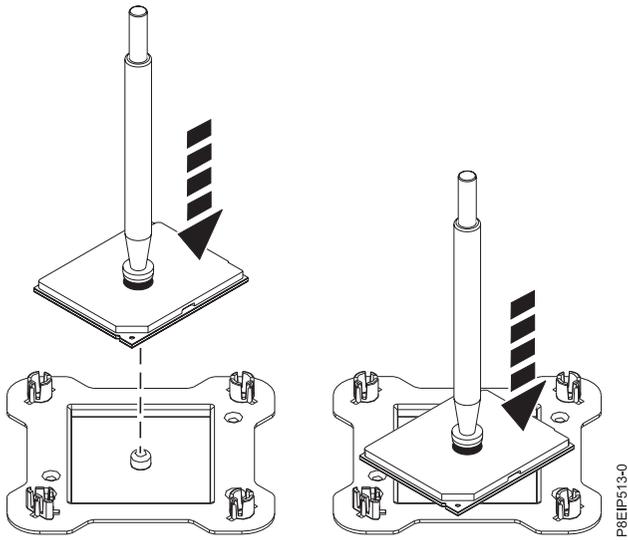


그림 29. 프로세서를 패키징의 맨 위 커버에 비스듬히 놓기

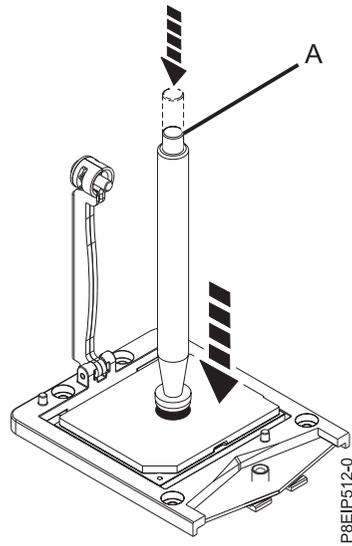


그림 30. 제거 도구를 시스템 프로세서 모듈 위에 내리기

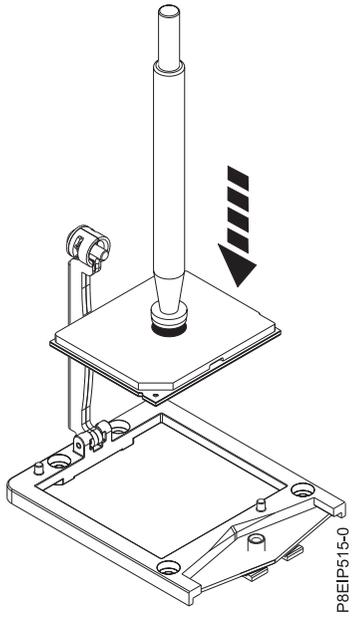


그림 31. 소켓으로 프로세서 내리기

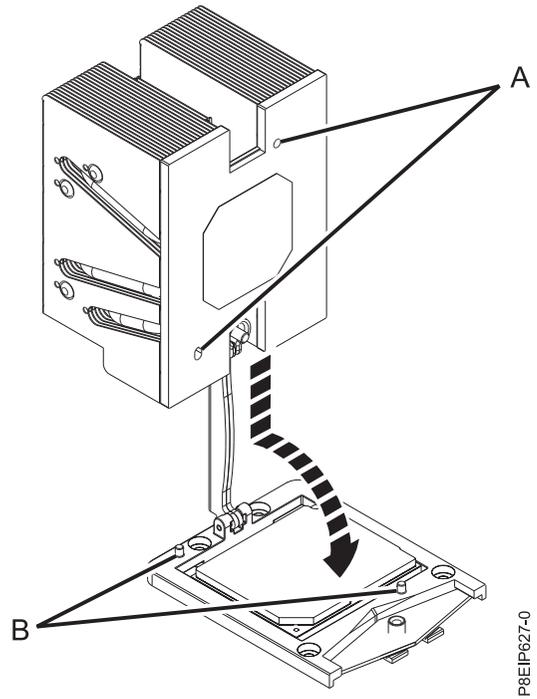


그림 32. 방열판 설치

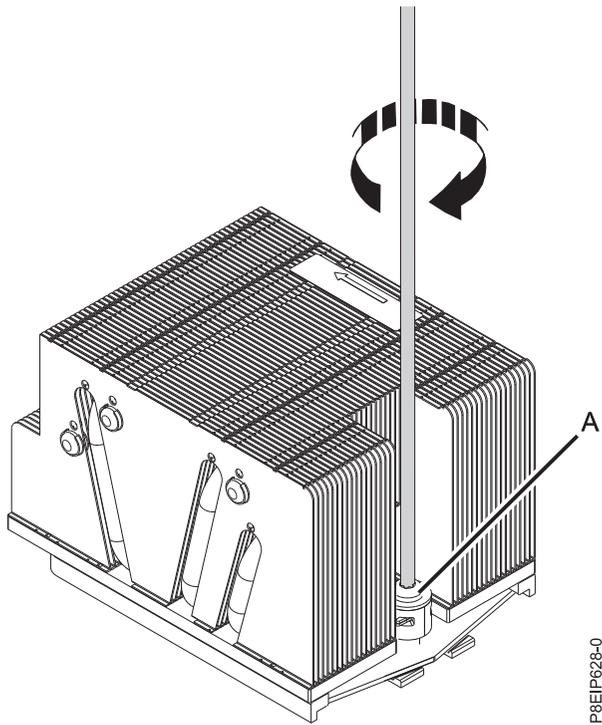
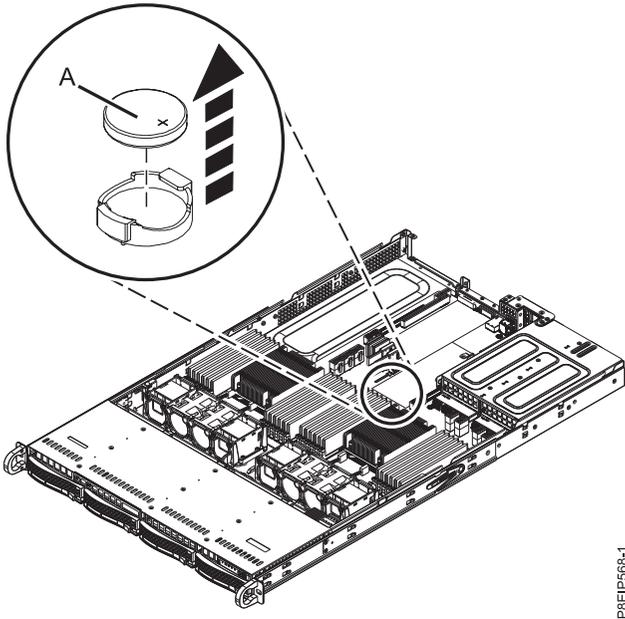


그림 33. 로드 암 나사 조이기



P9EIP568-1

그림 34. 일중 시간 배터리 위치